

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大見俊一郎 副委員長 宇佐美達矢

幹事 諏訪智之・野田泰史 幹事補佐 細井卓治・二瀬卓也

日時 2月7日(火) 10:00~17:00

会場 東大・本郷・武田ホール (〒113-8654 文京区本郷7-3-1 https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html)

議題 配線・実装技術と関連材料技術

- 〔招待講演〕 Cu配線以降の代替金属配線におけるメタル成膜起因の配線幅ばらつきとその抑制方法
本山幸一 (IBM)
- 〔招待講演〕 先端3D構造ロジック・メモリデバイスにおける原子層等方加工技術 大竹浩人 (日立ハイテク)
- 〔招待講演〕 2nm世代以降のロジックデバイスにむけた先端プロセス技術 山本知成 (東京エレクトロン)
- 〔招待講演〕 BSIピクセルピッチハイブリッド接合及び3層積層技術
○谷田一真・鈴木 繁・瀬尾俊紀・森永泰規・興梠隼人・手谷道成・浜田政一・江藤竜二・山下武志・加藤靖啓・佐藤直昭・清水但美・塙 哲郎・久保裕子・伊藤史隆・野口佳裕・中村成志・水越隆司・竹内雅彦・鈴木政勝・新添真人・宮永 績・池田 敦・松本 晋 (タワーパートナーズセミコンダクター)
- 〔招待講演〕 表面活性化接合の常温ヘテロインテグレーションへの適用 須賀唯知 (明星大)
- 〔招待講演〕 New Approach for Epoxy Mold Compound Slurry in Advanced Packaging Technology
○Shogo Arata・Chiaki Noda・Yasuhiro Ichige・Satoyuki Nomura (Resonac)・Trianggono Widodo・Nagatoshi Tsunoda・Xavier Brun (Intel)
- 〔招待講演〕 イオン液体中の電気化学反応を用いた Intelligent Connection Device の温度依存性
○小林正和 (長瀬産業)・島 久・内藤泰久・秋永広幸 (産総研)・佐藤 暖・松尾拓真・米澤雅陽・木下健太郎 (東京理科大)・伊藤敏幸 (豊田理研)・野上利材 (鳥取大)・折井靖光 (長瀬産業)
- 〔招待講演〕 次世代ウェアラブルデバイス：スキンエレクトロニクス 李 成薫 (東大)

◆応用物理学会共催

【問合先】

宇佐美 達矢 (日本エー・エス・エム)

TEL [042] 337-6310 (Ext 5717#)

E-mail: tatsuya.usami@asm.com

平野 博茂 (タワー パートナーズ セミコンダクター)

TEL [080] 4603-4128

E-mail: hirano.hiroshige@tpsemico.com